

<<电子技术实验教程>>

图书基本信息

书名：<<电子技术实验教程>>

13位ISBN编号：9787811402773

10位ISBN编号：7811402777

出版时间：2011-2

出版时间：浙江工商大学出版社

作者：朱金刚

页数：274

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电子技术实验教程>>

### 内容概要

编写《电子技术实验教程》时，突出了工程实践技能的培养要求，在保留必须的实验内容的同时，增加了印刷电路板设计、制作、焊接等工程实践内容和可编程逻辑器件的实验内容，几乎所有的数字逻辑实验都是设计性、综合性实验。

另外，能实现一定功能的开放性实验也是本书的一大亮点。

从内容上看，基础性实验的比例已不足40%，以工程训练实践为主的实验内容大大增加，实现了由点到面、由简单到复杂、从单元到综合的实验教学知识结构。

本书的最后一章(Multisim与电子线路仿真)，充分利用了先进的计算机仿真技术，实现了软件仿真与硬件电路设计的完整结合。

本书由朱金刚编著。

## &lt;&lt;电子技术实验教程&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第一章 数字电子技术基础实验

实验1-1 集成与非门参数测试

附录1-1 TTL门电路的使用规则

实验1-2 CMOS门电路及其应用

附录1-2 CMOS门电路使用注意事项

实验1-3 移位寄存器及其应用

实验1-4 集成计数器及其应用

实验1-5 555定时器及其应用

?验1-6 跟踪式A/D转换实验

## 第二章 可编程逻辑器件与逻辑设计实验

第一节 可编程逻辑器件(ATF16V8B)

第二节 PLD器件的开发软件winCUPL

实验2-1 组合逻辑电路设计( )

实验2-2 组合逻辑电路设计( )

实验2-3 组合逻辑电路设计( )

实验2-4 组合逻辑电路设计( )

实验2-5 时序逻辑电路设计( )

实验2-6 时序逻辑电路设计( )

实验2-7 时序逻辑电路设计( )

实验2-8 时序逻辑电路设计( )

实验2-9 8×8 LED显示屏的静态图案显示

实验2-10 8×8 LED显示屏的动态图案显示

实验2-11 小汽车尾灯控制电路设计

## 第三章 数字电路与数字逻辑设计开放性实验

实验3-1 微小电感测量电路设计

实验3-2 电容测量电路设计

实验3-3 8路抢答器的设计

## 第四章 模拟电子技术基础实验

实验4—1 常用电子仪器的使用

附录4-1 仪器使用说明

实验4-2 电子元件的识别与应用

附录4-2 常用电子元器件

实验4-3 共射极单管放大器实验

实验4-4 差动放大器实验

实验4-5 音频功率放大器及其性能指标测量

附录4-5-1 印刷电路板设计技术

附录4-5-2 焊接工艺

实验4-6 稳压电源性能测试

实验4-7 集成运算放大器指标测试

实验4-8 集成运算放大器的基本应用

实验4-9 集成运算放大器的综合应用

实验4-10 有源滤波器实验

## 第五章 模拟电子技术开放性实验

实验5-1 功率恒流源

实验5-2 恒温电路设计

## <<电子技术实验教程>>

### 第六章 Multisim与电子线路仿真

第一节 Multisim 8的操作界面

第二节 Multisim 8的虚拟仪器使用方法

第三节 Multisim 8的分析方法

第四节 Multisim 8的定制电路功能

第五节 Multisim 8常用电路分析

参考文献

章节摘录

焊接过程包括“润湿”和“扩展”两个过程，焊点的可靠性也由这两个过程完成的质量来决定。

1.1润湿过程 熔融的焊料涂覆在铜箔表面后，形成均匀、滑润、不断裂的焊料箔层。焊料借助被焊金属表面毛细管力，沿着金属表面细微的凹凸及间隙四周漫流的过程，称为“润湿”过程。若熔融的焊料涂覆在铜箔表面后，焊料回缩分离，形成不规则的焊料疙瘩或球状，但金属表面仍有一层焊料箔层，而不露出基本铜箔，称为半润湿，若焊料不附着铜箔表面，称之为不润湿。

<<电子技术实验教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>